LED SPECIFICATION

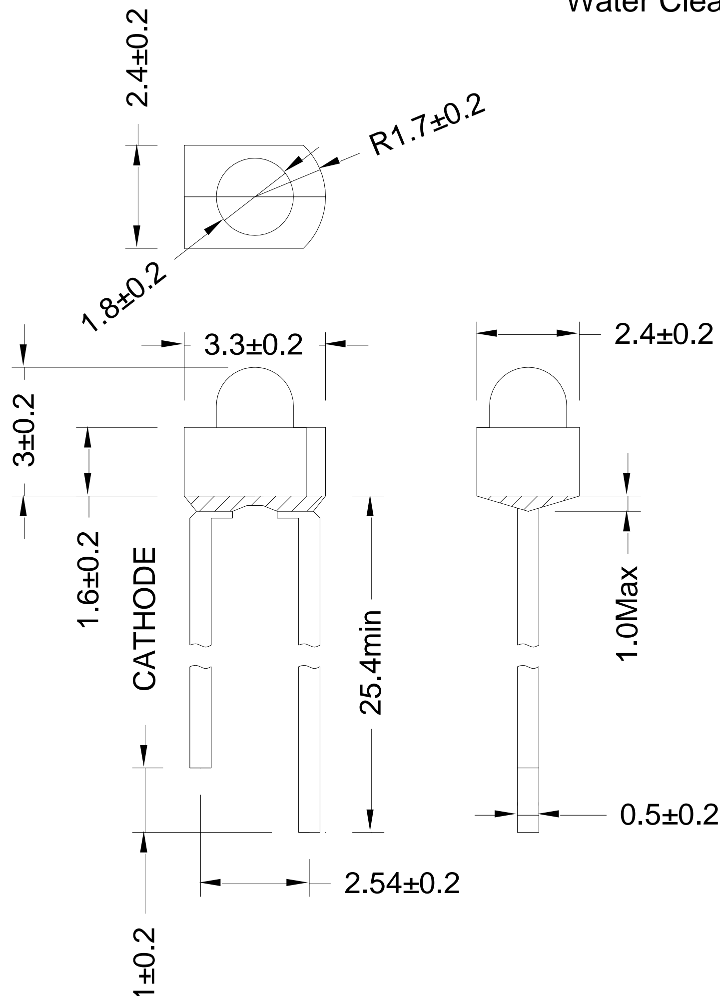
Part No./型号： 130MR2C

➢ Features/特征：

- Single color/单色
- High bright output/高亮度输出
- Low power consumption/低功耗
- High reliability and long life/
  可靠性高、寿命长

➢ Descriptions/描述：

- Dice material/芯片材质：AlGaInP
- Emitting Color/发光颜色：
  Super Bright Red/ 高亮度红色
- Device Outline/产品外形：
  Special Type/ 特殊形状
- Lens Type 胶体颜色：
  Water Clear/ 无色透明



1. All dimensions are millimeters/单位：mm.
2. Tolerance is +/-0.25mm unless otherwise noted/
   没有标注的公差均为±0.25mm.

Part No./型号： 130MR2C

➢ Absolute maximum ratings/极限参数（Ta = 25℃）

Parameter 参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Values 数值		Unit 单位
			Min.	Max.	
Reverse Voltage 反向电压	V_R	I_R = 30 μ A	5	----	V
Forward Current 正向工作电流	I_F	----	----	30	mA
Power Dissipation 损耗功率	P_d	----	----	72	mW
Pulse Current 正向峰值电流	I_{peak}	Duty=0.1mS，1kHz	----	100	mA
Operating Temperature 工作温度范围	T_{opr}	----	-40	+85	℃
Storage Temperature 储存温度范围	T_{str}	----	-40	+100	℃
Soldering Temperature 焊接温度	T_{sd}	t≤3sec,2mm from case	----	260	℃

➢ Electrical and optical characteristics/光电参数（Ta = 25℃）

Parameter 参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Values 数值			Unit 单位
			Min.	Typ.	Max.	
Forward Voltage 正向电压	V_F	I_F=20mA	1.8	2.1	2.4	V
Reverse Current 反向电流	I_R	V_R=5V	----	----	30	μ A
Dominate Wavelength 主波长	λ_d	I_F=20mA	----	622	----	nm
Peak Wavelength 峰值波长	λ_p	I_F=20mA	----	632	----	nm
Spectral Line half-width 半波长宽度	$\Delta\lambda$	I_F=20mA	----	30	----	nm
Luminous Intensity 发光强度	I_V	I_F=20mA	----	4800	----	mcd

➢ Luminous Intensity Bins/亮度等级分档（Ta = 25℃）

Unit:mcd

Bin	W	X	Y
Min	3000	4180	5860
Max	4180	5860	8200

➢ Forward Current Bins/电压等级分档（Ta = 25℃）

Unit:V

Bin	V2	V3	V4
Min	1.8	2.0	2.2
Max	2.0	2.2	2.4

Part No./型号： 130MR2C

➢ Typical electrical/optical characteristic curves/光电特性曲线：

Fig.1 正向电流 Vs. 正向电压

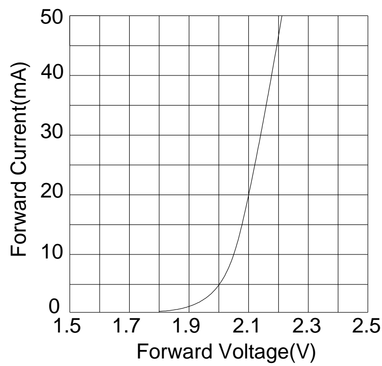


Fig.2 相对亮度 Vs. 正向电流

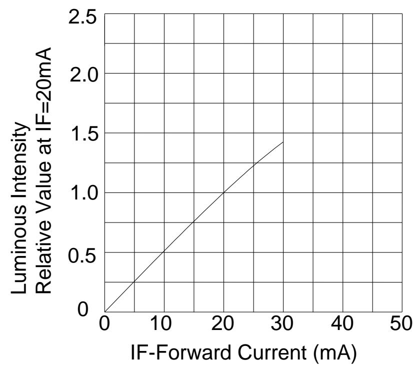


Fig.3 正向电流 Vs. 环境温度

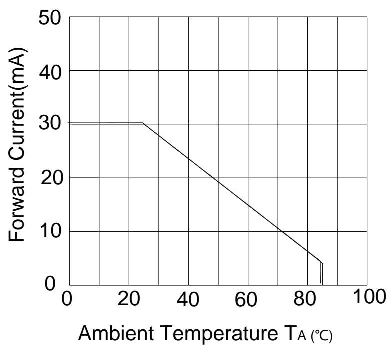


Fig.4 相对亮度 Vs. 环境温度

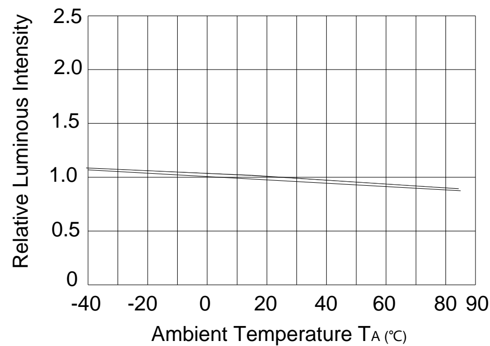
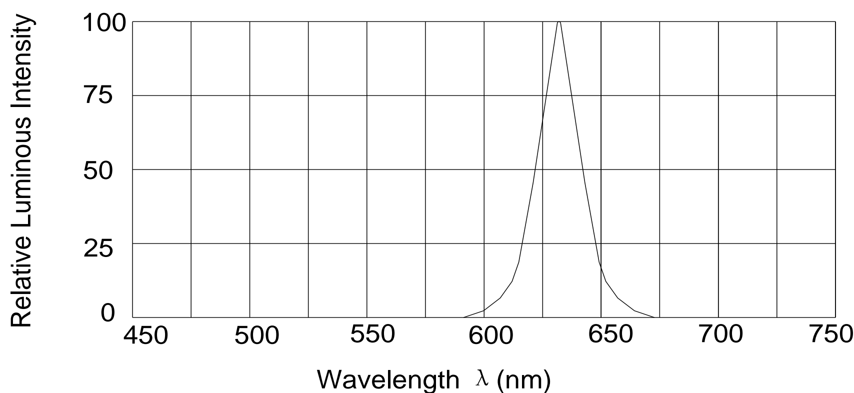


Fig.5 辐射强度 Vs. 波长



➢ Soldering Condition/焊接条件

Careful attention should be paid during soldering. When soldering, leave more then 2mm from solder joint to case, and soldering beyond the base of the tie bar is recommended.

焊接时请特别注意，焊接点要离LED封装体底部2mm以上。

Avoiding applying any stress to the lead frame while the LEDs are at high temperature particularly when soldering.

在 LED 处于高温，特别是在焊接时，请避免对支架施压。

Recommended soldering conditions/推荐焊接条件:

Hand Soldering 手工焊接		DIP Soldering 浸焊	
Temp.at tip of iron 电烙铁温度	300℃Max.(30WMax.) 最高温度300℃（功率不超过30瓦）	Preheat temp. 预热温度	100℃ Max. (60 sec Max.) 最高温度100℃（不超过60秒）
Soldering time 焊接时间	3 sec Max. 时间不超过3秒	Bath temp. 浸焊温度	260℃ Max 最高260℃.
Distance 焊接位置	2mm Min.(From solder joint to case) 大于2毫米（从焊点到胶体）	Bath time. 浸焊时间	3 sec Max. 不超过3秒
		Distance 浸焊位置	2mm Min 大于2毫米.